

МЕТАЛЛЫ И ПОЛУПРОВОДНИКИ: ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ

МОДУЛЬ 1. Методы получения объемных моно- и поликристаллических материалов

(лекции - 10 ч., лабораторные работы - 4 ч., практические занятия – 10 ч.)

МОДУЛЬ 2. Процессы и методы формирования наноструктурных состояний в конструкционных материалах

(лекции - 10 ч., лабораторные работы - 4 ч., практические занятия – 10 ч.)

МОДУЛЬ 3. Тонкие пленки и покрытия

(лекции - 12 ч., лабораторные работы - 8 ч., практические занятия – 12 ч.)

Контролирующие мероприятия
Тестирование
Защита лабораторных работ
Проверка индивидуальных заданий
Экзамен

МЕТАЛЛЫ И ПОЛУПРОВОДНИКИ: ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ

МОДУЛЬ 1. Методы получения объемных моно- и поликристаллических материалов

Лекция 1.

Металлы, полупроводники, диэлектрики. Электронное строение. Зонная диаграмма. Физические, химические, механические и технологические свойства. Основные области применения.

Металлы — группа элементов, в виде простых веществ, обладающих характерными *металлическими* свойствами, такими, как высокие тепло- и электропроводность, положительный температурный коэффициент сопротивления, высокая пластичность, ковкость и металлический блеск.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

ПЕРИОДЫ	Г Р У П П Ы Э Л Е М Е Н Т О В																													
	A I B			A II B			A III B			A IV B			A V B			A VI B			A VII B			A O B			VIII			B		
1	(H)																													
2	Li 6.941 Литий			Be 9.0122 Бериллий			B 10.811 Бор			C 12.011 Углерод			N 14.007 Азот			O 15.999 Кислород			F 18.998 Фтор			Ne 20.179 Неон			Ar 39.948 Аргон					
3	Na 22.99 Натрий			Mg 24.305 Магний			Al 26.9815 Алюминий			Si 28.086 Кремний			P 30.974 Фосфор			S 32.066 Сера			Cl 35.453 Хлор			Ar 39.948 Аргон								
4	K 39.098 Калий			Ca 40.08 Кальций			Sc 44.956 Скандий			Ti 47.90 Титан			V 50.941 Ванадий			Cr 51.996 Хром			Mn 54.938 Марганец			Fe 55.847 Железо			Co 58.933 Кобальт			Ni 58.70 Никель		
5	Cu 63.546 Медь			Zn 65.39 Цинк			Ga 69.72 Галлий			Ge 72.59 Германий			As 74.992 Мышьяк			Se 78.96 Селен			Br 79.904 Бром			Kr 83.80 Криптон								
	Rb 85.468 Рубидий			Sr 87.62 Стронций			Y 88.906 Иттрий			Zr 91.22 Цирконий			Nb 92.906 Ниобий			Mo 95.94 Молибден			Tc 97.91 Технеций			Ru 101.07 Рутений			Rh 102.906 Родий			Pd 106.4 Палладий		
6	Ag 107.868 Серебро			Cd 112.41 Кадмий			In 114.82 Индий			Sn 118.71 Олово			Sb 121.75 Сурьма			Te 127.60 Теллур			I 126.9045 Йод			Xe 131.29 Ксенон								
	Cs 132.905 Цезий			Ba 137.33 Барий			La* 138.9055 Лантан			Hf 178.49 Гафний			Ta 180.9479 Тантал			W 183.85 Вольфрам			Re 186.207 Рений			Os 190.2 Осмий			Ir 192.22 Иридий			Pt 195.08 Платина		
7	Au 196.967 Золото			Hg 200.59 Ртуть			Tl 204.38 Таллий			Pb 207.19 Свинец			Bi 208.980 Висмут			Po 209.96 Полоний			At 209.99 Астат			Rn [222] Радон								
	Fr [223] Франций			Ra [226] Радий			Ac** [227] Актиний			Rf [261] Рифтордий			Db [262] Дубний			Sg [263] Сибборгий			Bh [264] Борий			Hs [265] Хассий			Mt [266] Мейтнерий					
Формулы высоких окислов Формулы летучих однородных соединений R₂O RO R₂O₃ RH₄ RO₂ RH₃ RO₃ RH₂ RO₄																														
ЛАНТАНОИДЫ*	Ce 140.12 Церий	Pr 140.908 Прометий	Nd 144.24 Неодим	Pm 144.91 Прометий	Sm 150.36 Самарий	Eu 151.96 Европий	Gd 157.25 Гадолиний	Tb 158.925 Тербий	Dy 162.50 Диспрозий	Ho 164.930 Гольмий	Er 167.26 Ербий	Tm 168.934 Туллий	Yb 173.04 Иттербий	Lu 174.967 Лютеций																
АКТИНОИДЫ**	Th 232.038 Торий	Pa 231.04 Протактиний	U 238.03 Уран	Np 237.05 Нептуний	Pu 244.06 Плутоний	Am 243.06 Америций	Cm 247.07 Курций	Bk 247.07 Берклий	Cf 251.08 Калифорний	Es 252.08 Эйнштейний	Fm 257.10 Фермий	Md 288.10 Менделевий	No 289.10 Нобелий	Lr 260.10 Лавриций																

К металлам относятся:

6 элементов в группе щелочных металлов: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

4 в группе щёлочноземельных металлов: Ca, Sr, Ba, Ra

а также вне определённых групп бериллий и магний

40 в группе переходных металлов:
— Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn;

— Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd;

— La, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg;

— Ac, Rf, Db, Sg, Bh, Hs, Mt, Ds, Rg, Cn;

7 в группе лёгких металлов: Al, Ga, In, Sn, Tl, Pb, Bi

7 в группе полуметаллов: B, Si, Ge, As, Sb, Te, Po

14 в группе лантаноиды + лантан (La): Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu

14 в группе актиноиды (физические свойства изучены не у всех элементов) + актиний (Ac):

Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr.

Металлические сплавы по свойствам имеют много общего с металлами, поэтому их нередко относят к металлам.

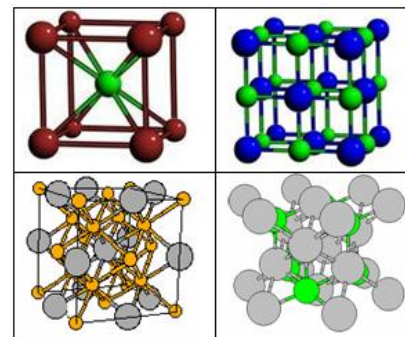
Сплав — макроскопически однородный **металлический** материал, состоящий из смеси двух или большего числа химических элементов с преобладанием металлических компонентов.

Сплавы состоят из основы (одного или нескольких металлов), малых добавок специально вводимых в сплав легирующих и модифицирующих элементов, а также из неудалённых примесей (природных, технологических и случайных).

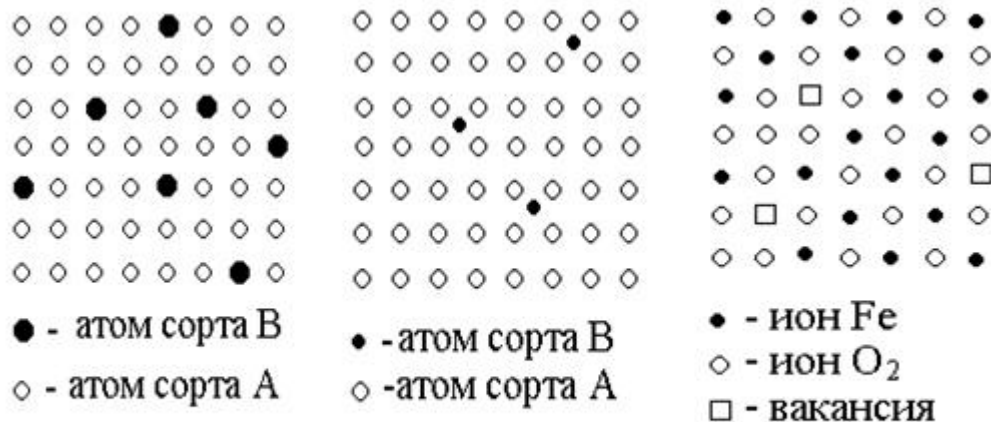
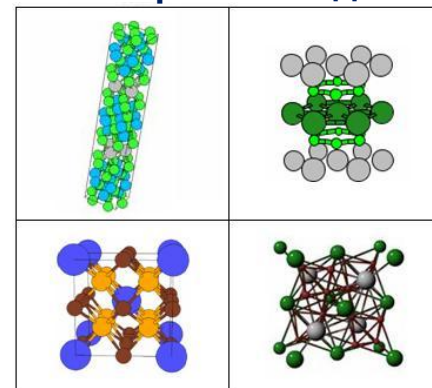
Сплавы можно классифицировать так:

- **твёрдые растворы замещения** (часть атомов основного вещества **заменена** на атомы примесного элемента)
- **твёрдые растворы внедрения** (часть **межузельных** полостей решётки занята атомами другого элемента)
- **твёрдые растворы вычитания** (растворы с дефектной решеткой)
- смеси индивидуальных кристаллов металлов
- смеси кристаллов интерметаллических соединений

Двухкомпонентные интерметаллиды



Трехкомпонентные интерметаллиды



Полупроводниковые материалы по структуре делятся на **кристаллические, твёрдые, аморфные и жидкие**.

Кристаллические полупроводниковые материалы

Элементарные полупроводники, Соединения типа $A^{III}B^V$, соединения элементов VI группы (O, S, Se, Te) с элементами I—V групп периодической системы, а также с переходными металлами и редкоземельными элементами, тройные соединения типа $A^{II}B^{IV}C^V_2$, химическое соединение карбид кремния SiC.

Органические полупроводники - твёрдые органические вещества, которые имеют (или приобретают под влиянием внешних воздействий) электронную или дырочную проводимости.

Некристаллические полупроводниковые материалы

Типичными представителями этой группы являются стеклообразные полупроводниковые материалы — халькогенидные и оксидные. К первым относятся сплавы Tl, P, As, Sb, Bi с S, Se, Te, характеризующиеся широким диапазоном значений удельной электрической проводимости, низкими температурами размягчения, устойчивостью к кислотам и щелочам. Типичные представители: As_2Se_3 - As_2Te_3 , Tl_2Se - As_2Se_3 . Оксидные стеклообразные полупроводниковые материалы имеют состав типа V_2O_5 - P_2O_5 - RO_x (R-металл I—IV гр.) и характеризуются удельной электрической проводимостью 10^{-4} – 10^{-5} Ом⁻¹см⁻¹

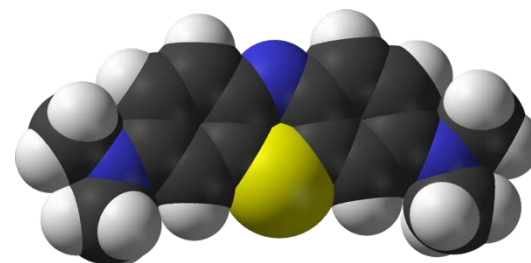
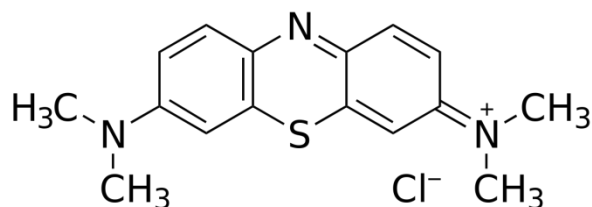
К **органическим полупроводникам** относятся органические красители (например, метиленовый голубой, фталоцианины), ароматические соединения (нафталин, антрацен, виолантрен и др.), полимеры с сопряжёнными связями, некоторые природные пигменты (хлорофилл, бета-каротин и др.), молекулярные комплексы с переносом заряда, а также ион-радикальные соли.

Органические полупроводники существуют в виде монокристаллов, поликристаллических или аморфных порошков и плёнок.

Метиленовый синий ([лат.](#) *Methylenum coeruleum*) (*N,N,N',N'*-тетраметилтионина хлорид тригидрат, 3,7-бисдиметиламинофенотиоцианит хлорид, метиловая синь, метиленовый голубой). Представляют собой тёмно-зеленые кристаллы с бронзовым блеском.



Химическая формула $C_{16}H_{18}ClN_3S$



Тип химической связи оказывает ярко выраженное влияние на структуру и физические свойства элементов и соединений

Химическая связь - это сила, удерживающая вместе два или несколько атомов, ионов, молекул или любую комбинацию из них. По своей природе она представляет собой электростатическую силу притяжения между отрицательно заряженными электронами и положительно заряженными ядрами.

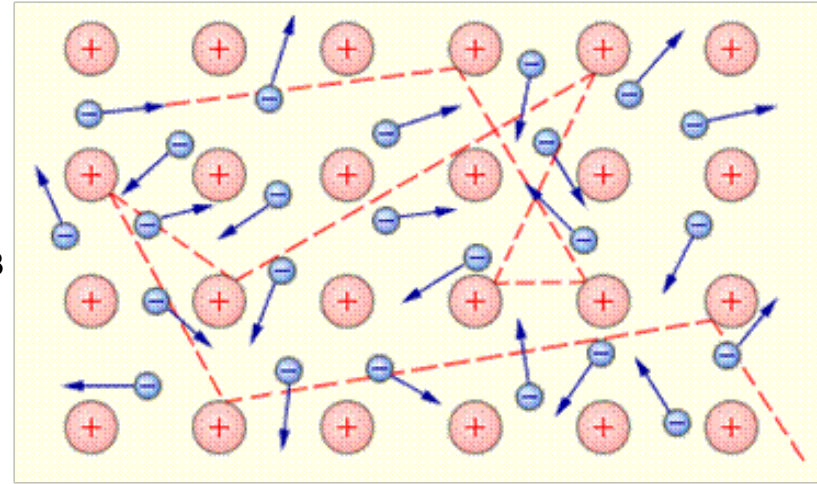
Таблица. Типы химической связи и их основные отличительные признаки.

Химическая связь	Связываемые атомы	Характер элементов	Процесс в электронной оболочке	Образующиеся частицы	Кристаллическая решетка	Характер вещества	Примеры
Ионная	Атом металла и атом неметалла	Электроположительный и электроотрицательный	Переход валентных электронов	Положительные и отрицательные ионы	Ионная	Солеобразный	NaCl CaO NaOH
	Атомы неметаллов (реже-атомы металлов)	Электроотрицательный реже электроположительный	Образование общих электронных пар, заполнение молекулярных орбиталей	Молекулы	Молекулярная	Летучий или нелетучий	Br ₂ CO ₂ C ₆ H ₆
Ковалентная				-----	Атомная	Алмазоподобный	Алмаз Si SiC
Металлическая	Атомы металлов	Электроположительный	Отдача валентных электронов	Положительные ионы и электронный газ	Металлическая	Металлическая	Металлы и сплавы

Типы связей в кристаллах

Металлическая связь.

Атомы большинства металлов на внешнем уровне имеют малое количество электронов – 1,2,3. Эти электроны легко отрываются и атомы металлов становятся ионами.



Положительные ионы металлов располагаются в узлах ОЦК, ГЦУ и ГПУ кристаллической решётки. Между ними беспорядочно, подобно молекулам газа, движутся валентные электроны, отщепившиеся от атомов при образовании ионов.

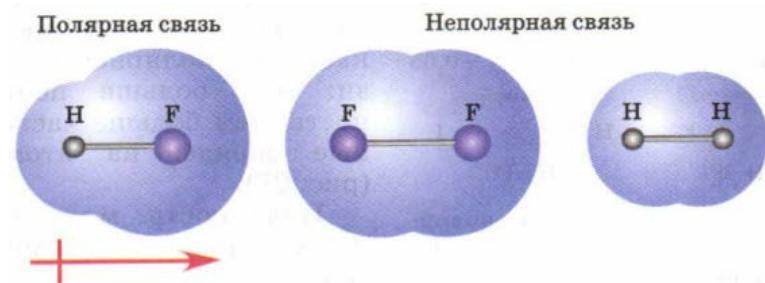
Между ионами и свободными электронами возникают электростатические взаимодействия, которые и являются причиной возникновения металлической связи

При этом оторвавшиеся электроны могут перемещаться от одного иона к другому то есть становятся свободными, и как бы связывая их в единое целое. Иными словами, все оторвавшиеся электроны являются общими, так как нельзя понять какой электрон принадлежит какому из атомов металла.

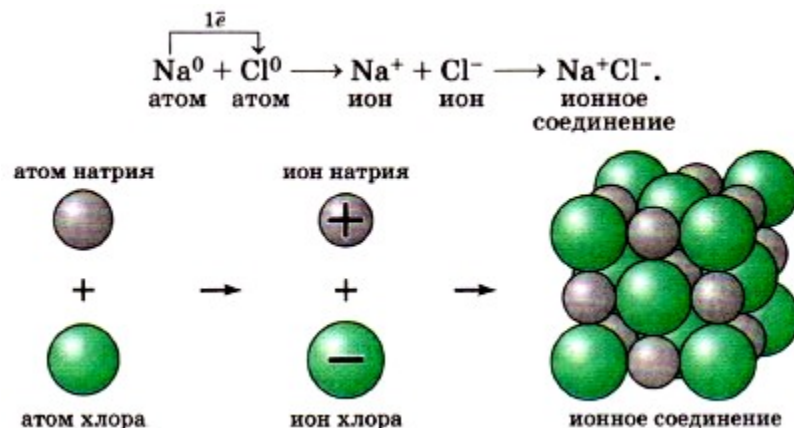
Электроны могут объединяться с катионами, тогда временно образуются атомы, от которых потом вновь отрываются электроны. Этот процесс происходит постоянно и без остановки. То есть в объеме металла атомы непрерывно превращаются в ионы и наоборот.

Типы связей в кристаллах

Ковалентная связь. Нейтральные атомы размещены в узлах кристаллической решётки. Связь образуется направленными валентными электронными облаками.



Ионная связь. В узлах кристаллической решётки помещаются положительно и отрицательно заряженные ионы. Силы взаимодействия между узлами являются в основном электростатическими (кулоновскими).



Металлическая связь обуславливает основные свойства металлов

- Электропроводность

Причина **высокой электропроводности металлов** заключается в слабой связи электронного газа с положительно заряженными ионами. Достаточно приложить небольшую разность электрических потенциалов к концам металлического тела, чтобы вызвать перемещение электронного газа - **электрический ток**.



Концентрация свободных электронов составляет порядка 10^{28} м^{-3} , что соответствует концентрации атомов.

Сопротивление металлов объясняется столкновениями электронов проводимости с ионами кристаллической решетки. Чем чаще происходят такие столкновения, т. е. чем меньше среднее время свободного пробега электрона между столкновениями, тем больше удельное **сопротивление** металла.

- **теплопроводность**

Теплопроводность металлов также вызвана высокой подвижностью свободных электронов: сталкиваясь с колеблющимися в узлах решетки ионами, электроны обмениваются с ними энергией. С повышением температуры колебания ионов при посредстве электронов передаются другим ионам, и температура всего металла быстро выравнивается.

- **пластичность**

Связи между слоями металла не очень значительны, это позволяет перемещать слои под нагрузкой (деформировать металл не разрушая его). Наилучше деформирующиеся металлы (мягкие) Au, Ag, Cu.

- **металлический блеск**

Электронный газ отражает почти все световые лучи. Именно поэтому чистые металлы сильно блестят и чаще всего имеют серый или белый цвет.

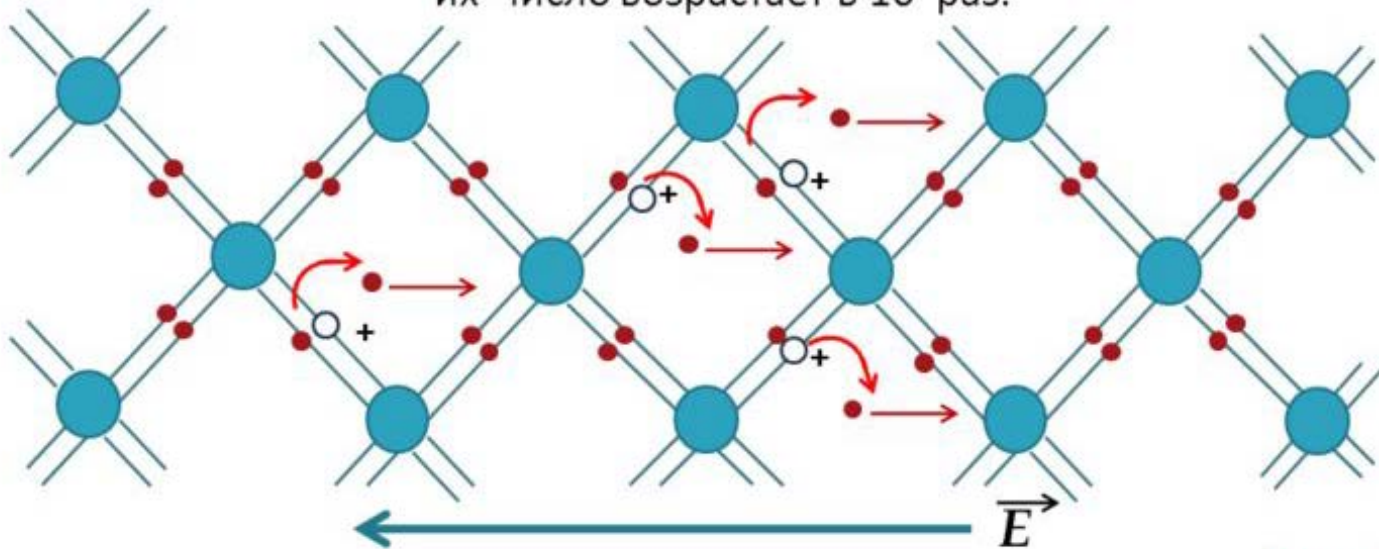
Белый и серый цвета большинства металлов говорят о том, что металлы рассеивают в равной степени все лучи видимой части спектра.

Золото и медь в большей степени поглощают лучи с **короткой** длиной волны (близкие к фиолетовым лучам) и отражают **длинноволновые** лучи, поэтому окрашены соответственно в **желтый** и **желто-красный** цвета.

Полупроводники – это материалы, которые по своей проводимости занимают промежуточное место между проводниками и диэлектриками, и отличаются от проводников сильной зависимостью проводимости от концентрации примесей, температуры и различных видов излучения.

Основное свойство полупроводников – **увеличение** электрической проводимости с **ростом** температуры.

При повышении температуры отдельные связи разрываются, электроны становятся «свободными», в электрическом поле они перемещаются упорядоченно, образуя ток. При увеличении температуры от 300 К до 700 К их число возрастает в 10^7 раз.



При разрыве связи образуется вакантное место, которое называют **дыркой**.

В дырке имеется избыточный положительный заряд.

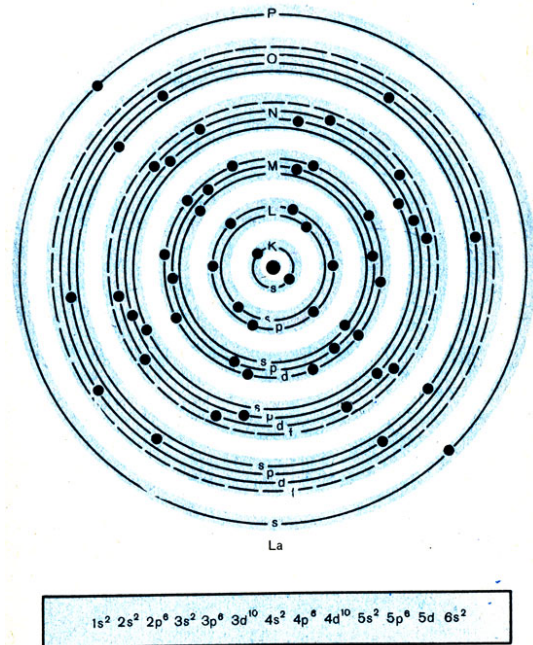
В **собственных** полупроводниках электронный ток равен дырочному!

Зонная теория

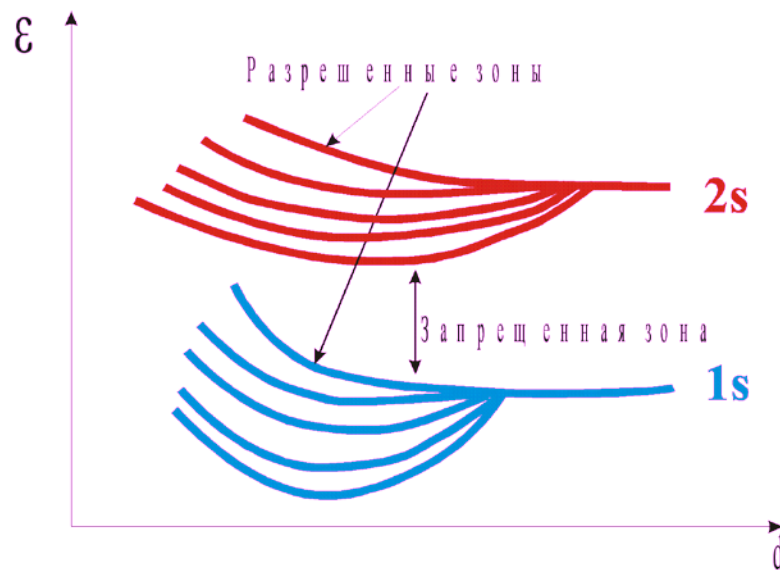
В соответствии с квантовой механикой свободные электроны могут иметь любую энергию — их энергетический спектр непрерывен.

Электроны, принадлежащие изолированным **атомам**, имеют определённые дискретные значения энергии.

В случае нескольких атомов, объединённых химической связью (например, в **молекуле**), электронные орбитали расщепляются в количестве, пропорциональном числу атомов, образуя так называемые молекулярные орбитали.

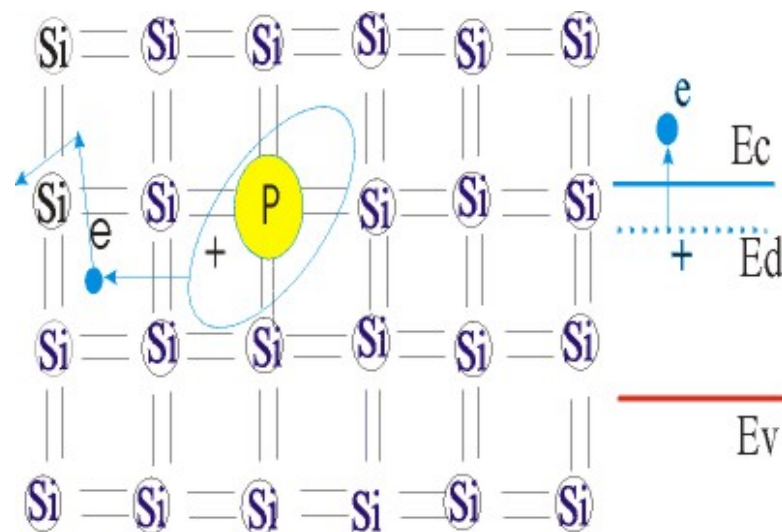
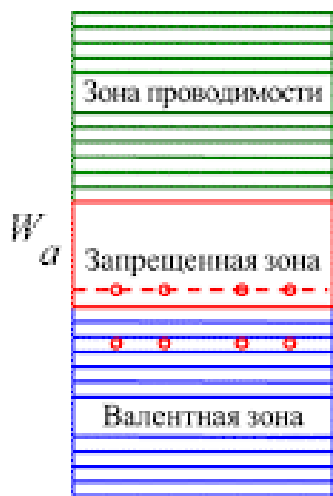
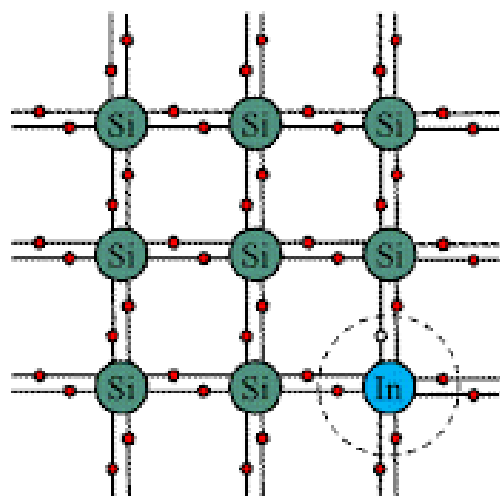
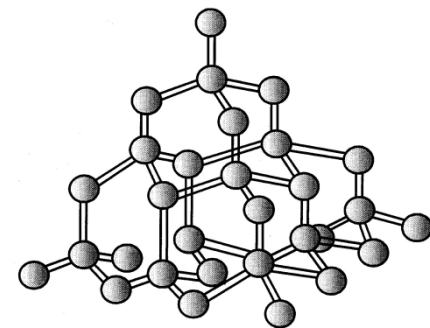
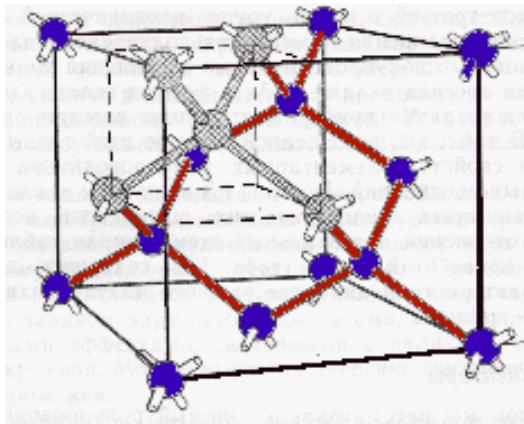


При дальнейшем увеличении системы до макроскопического **кристалла** (число атомов более 10^{22} см^{-3}), возникает такое же количество уровней в зонах. При этом расстояние между уровнями становится чрезвычайно малым, что позволяет считать, что энергия в разрешенной зоне изменяется непрерывно.



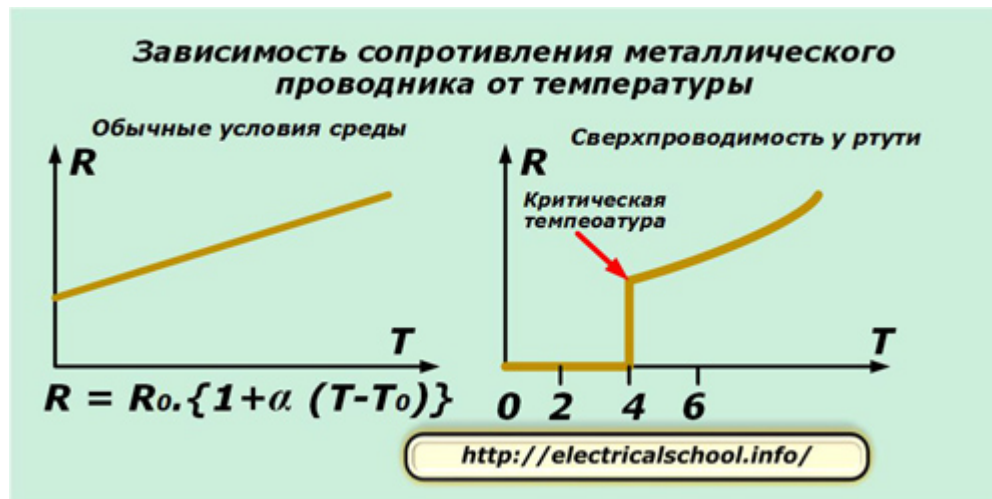
Тогда электрон, попавший в незанятую зону можно рассматривать как классический, считая, что под действием электрического поля он набирает непрерывно энергию, а не квантами, т.е. ведет себя как классическая частица.

Примесные полупроводники



Полупроводники, содержащие акцепторные примеси, называются полупроводниками р – типа от слова positive – положительный

Полупроводники, содержащие донорные примеси, называются полупроводниками п – типа от слова negative – отрицательный

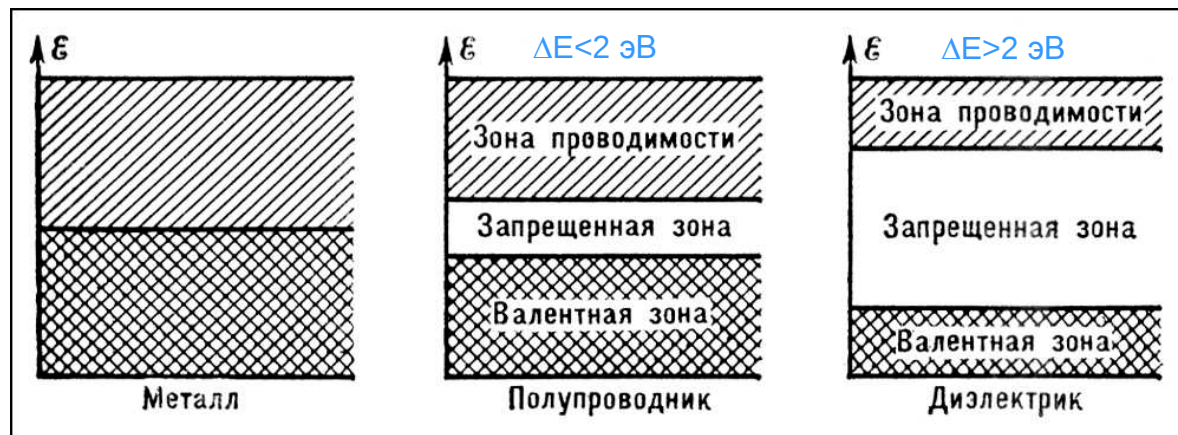


$$\operatorname{tg} \alpha = -\Delta E_g / 2k$$



$$\operatorname{tg} \alpha_n = -\Delta E_d / 2k$$

Рис. 9. График зависимости логарифма электропроводности полупроводника от обратной температуры



В **диэлектриках** электропроводность складывается из **ионной** и **электронной** электропроводностей.

Причем, для **диэлектриков** наиболее характерна **ионная электропроводность**, в то время как **электронная** электропроводность, как правило, наблюдается **только** в сильных электрических полях

Под действием тепловых флуктуаций ионы получают энергию, достаточную, чтобы покинуть нормальные положения в решетке и попасть в пространство между нормально закрепленными ионами (междоузлия).

При приложении электрического поля эти межузельные ионы перескакивают из одного межузельного положения в другое в направлении поля.

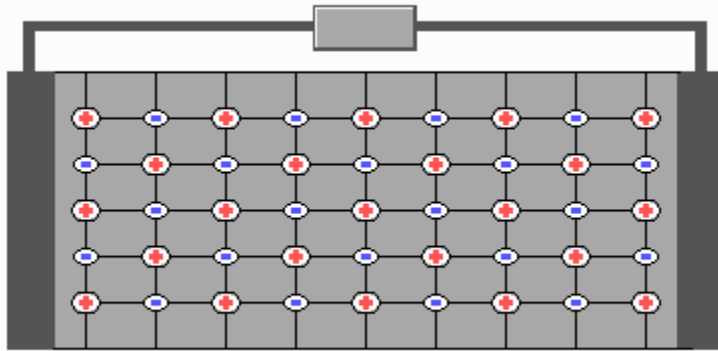
Таким образом, через диэлектрик будет протекать электрический ток.

Электронная электропроводность не сопровождается переносом вещества.

Ионная – сопровождается.

Следовательно, так можно экспериментально определить вид электропроводности.

Подключите напряжение !



Механизм электропроводности по Френкелю

Ток проводимости в твердых диэлектриках обуславливается направленным перемещением ионов примесей и ионов самого диэлектрика.

В диэлектриках **с атомными и молекулярными решетками** (парафин, полиэтилен и др.) ток проводимости обусловлен только ионами различных примесей.

У таких диэлектриков электропроводность весьма мала!

С течением времени ионная проводимость твердого диэлектрика понижается в связи с уменьшением количества ионов примесей, которые, дойдя до электродов, нейтрализуют свои заряды.

В **ионных** кристаллических диэлектриках (слюда и др.) ток проводимости составляют не только ионы примесей, но ионы самой кристаллической решетки. Последние могут быть сорваны электрическим полем с мест, где они были слабо закреплены (междоузлия), а также из узлов кристаллической решетки при одновременном воздействии на нее электрического поля и высокой температуры.

В **аморфных** диэлектриках (неорганические стекла) ионная электропроводность обусловлена электролизом различных окислов, входящих в состав самих стекол.

Другие физические химические и механические свойства

К основным характеристикам проводниковых материалов относятся:

- удельное сопротивление и удельная проводимость;
- температурный коэффициент удельного электрического сопротивления; термоэлектродвижущая сила (термоэдс);
- теплопроводность;
- теплостойкость;
- предел прочности на разрыв и относительное удлинение при разрыве

Ширина запрещенной зоны хорошо коррелирует с температурой плавления. Обе эти величины возрастают с ростом энергии связи атомов в кристаллической решётке, поэтому для широкозонных полупроводниковых материалов характерны высокие температуры плавления, что создает большие трудности на пути создания чистых и структурно совершенных монокристаллов таких полупроводниковых материалов.

Применение металлов



Конструкционные материалы

Металлы и их [сплавы](#) — одни из главных конструкционных материалов современной цивилизации. Это определяется, прежде всего, их высокой [прочностью](#), однородностью и непроницаемостью для [жидкостей](#) и [газов](#). Кроме того, меняя структуру сплавов, можно менять их свойства в очень широких пределах.

Электротехнические материалы

Металлы используются в качестве хороших [проводников](#) электричества (медь, алюминий), так и в качестве материалов с повышенным [сопротивлением](#) для [резисторов](#) и электронагревательных элементов ([нихром](#) и т. п.).



Инструментальные материалы

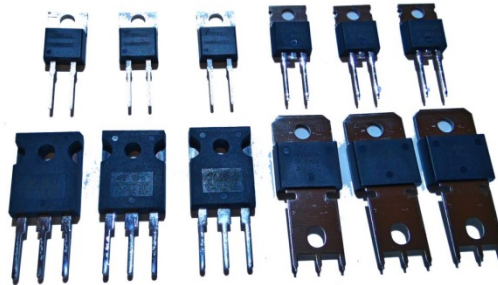
Металлы и их сплавы широко применяются для изготовления инструментов (их рабочей части). В основном, это [инструментальные стали](#) и [твёрдые сплавы](#).

В качестве инструментальных материалов применяются также [алмаз](#), [нитрид бора](#), [керамика](#).



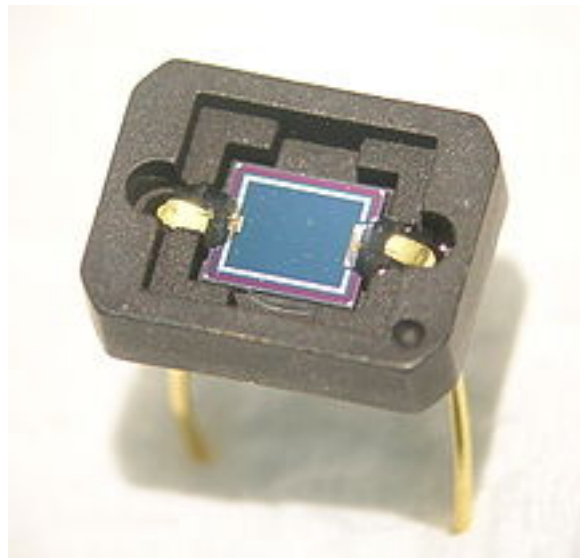
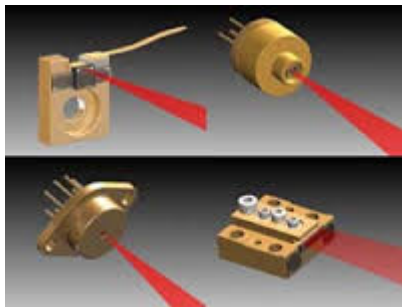
Важнейшая область применения полупроводниковых материалов — микроэлектроника

- **Интегральные схемы.** В настоящее время используется Si. Дальнейший прогресс в повышении быстродействия и в снижении потребляемой мощности связан с созданием интегральных схем на основе GaAs, InP и их твёрдых растворов с др. соединениями типа $A^{III}B^V$
- **«Силовые» полупроводниковые приборы** (вентили, тиристоры, мощные транзисторы). Здесь также основным материалом является Si, а дальнейшее продвижение в область более высоких рабочих температур связано с применением GaAs, SiC и др. широкозонных полупроводниковых материалов.
- **Солнечные батареи.** Основные материалы - Si, GaAs, гетероструктуры $Ga_xAl_{1-x}As/GaAs$, Cu_2S/CdS , $\alpha-Si:H$, гетероструктуры $\alpha-Si:H/\alpha-Si_xC_{1-x}:H$.



Полупроводниковые лазеры и фотоприемники — важнейшие составляющие элементной базы волоконно-оптической линий связи.

- **Полупроводниковые лазеры и светодиоды.** Лазеры делают на основе ряда прямозонных соединений типа $A^{III}B^V$, $A^{II}B^{IV}$, $A^{IV}B^{VI}$ и др. Важнейшими материалами для изготовления лазеров являются гетероструктуры: $Ga_xAl_{1-x}As/GaAs$, $Ga_xIn_{1-x}As_yP_{1-y}/InP$, $Ga_xIn_{1-x}As/InP$, $Ga_xIn_{1-x}As_yP_{1-y}/Ga_xAs_{1-x}P_x$, $GaN/Al_xGa_{1-x}N$. Для изготовления светодиодов широко используют: [GaAs](#), GaP , $GaAs_{1-x}P_x$, $Ga_xIn_{1-x}As$, $Ga_xAl_{1-x}As$, [GaN](#) и др.
- **Приемники оптического излучения** (фотоприемников) для широкого спектрального диапазона. Их изготавливают на основе [Ge](#), [Si](#), [GaAs](#), [GaP](#), [InSb](#), [InAs](#), $Ga_xAl_{1-x}As$, $Ga_xIn_{1-x}As$, $Ga_xIn_{1-x}As_yP_{1-y}$, $Cd_xHg_{1-x}Te$, $Pb_xSn_{1-x}Te$ и ряда др. полупроводниковых материалов.

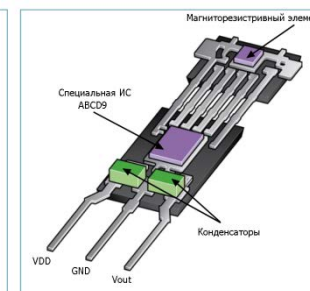
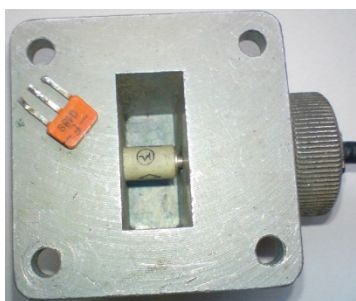


Полупроводниковые материалы используются для создания различных СВЧ приборов

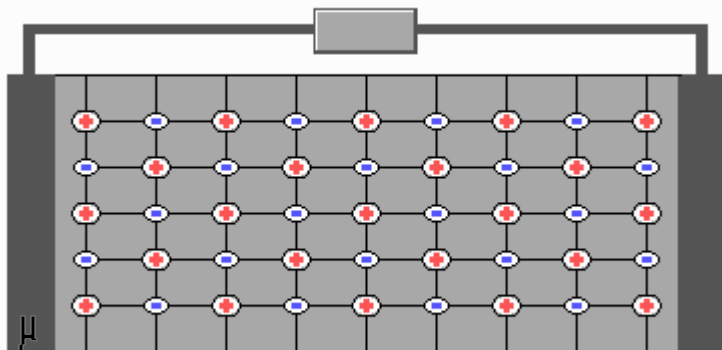
(биполярные и полевые транзисторы, лавинопролетные диоды и др.).

Другие важные области применения полупроводниковых материалов:

- детекторы ядерных излучений (используют особо чистые Ge, Si, GaAs, CdTe и др.),
- тензодатчики,
- высокочувствительные термометры,
- датчики магнитных полей и др.



Подключите напряжение !

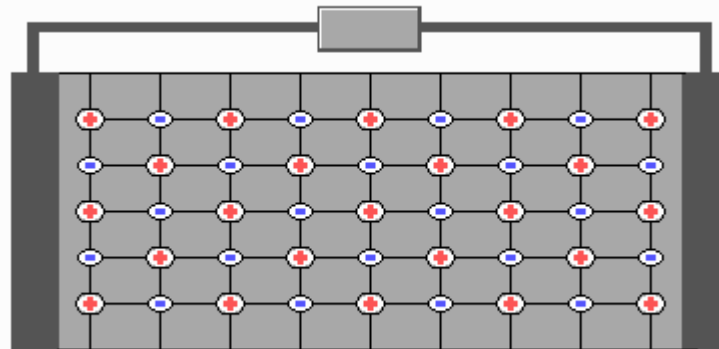


Механизм электропроводности по Френкелю

Механизм Фрэнкеля

Если при движении по кристаллу ион встречает вакантное место, то он снова закрепляется в узле решетки. Такой процесс приводит к обмену атомов местами, то есть к **диффузии**.

Подключите напряжение !



Механизм электропроводности по Шоттки

Механизм **Шоттки**. Дефекты образуются в результате удаления равного числа анионов (-) и катионов (+) из нормальных узлов решетки и помещения их в новые узлы на внешних и внутренних поверхностях кристалла. В этом случае вакансии перемещаются по кристаллу вследствие переноса в незанятый узел ионов из соседних узлов. Посмотрите, как происходит этот процесс.

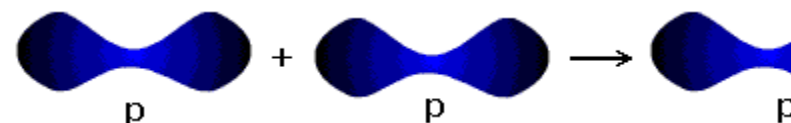
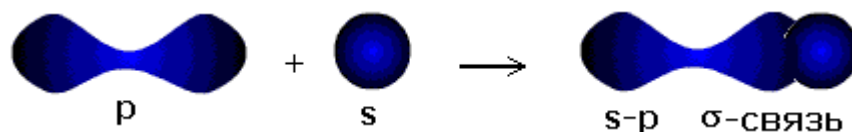
Пример. Образование молекулы хлора.

Точками обозначены электроны. При расстановке следует соблюдать правило: электроны ставятся в определённой последовательности. Новая электронная пара, возникшая из двух неспаренных электронов, становится общей для двух атомов хлора. Существует

σ - связь значительно прочнее π -связи, причём π -связь может быть только с σ -связью, За счёт этой связи образуются двойные

Полярные ковалентные связи образуются между атомами с разной электроотрицательностью.

За счёт $\text{H}\cdot + \cdot\text{Cl}\cdot \rightarrow \text{H}\text{Cl}$ водорода к хлору атом хлора заряжается частично отрицательно, водорода-частично положительно.



σ - σ - СВЯЗЬ

s - p - СВЯЗЬ

p - p - СВЯЗЬ

p - p - СВЯЗЬ

